

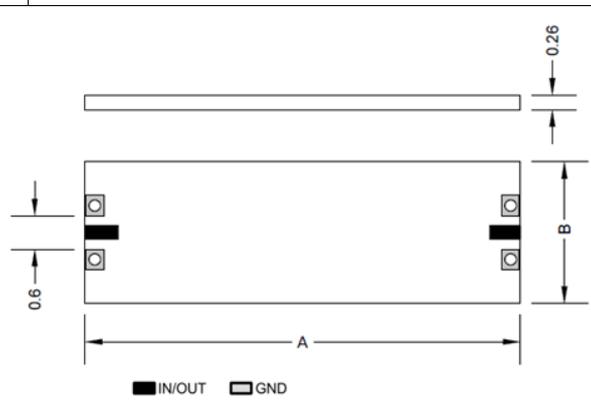
技术指标（常温+25℃）

序号	项目	技术指标
1-1	产品名称	薄膜微带滤波器
1-2	产品型号	YTFBP24/R2-4RA
1-3	中心频率 f_0	24GHz
1-4	工作频率	23.9-24.1GHz
1-5	中心损耗	$\leq 6.0\text{dB}$
1-6	带内波动	$\leq 1.0\text{dB}$
1-7	带外衰减	$\geq 20\text{dB}@23.4\text{GHz}$ $\geq 20\text{dB}@24.5\text{GHz}$
1-8	带内驻波比	≤ 1.8
1-9	输入输出阻抗	50 欧姆
1-10	输出安装方式	键合
1-11	产品尺寸	4.3mm*2.4mm*0.26mm

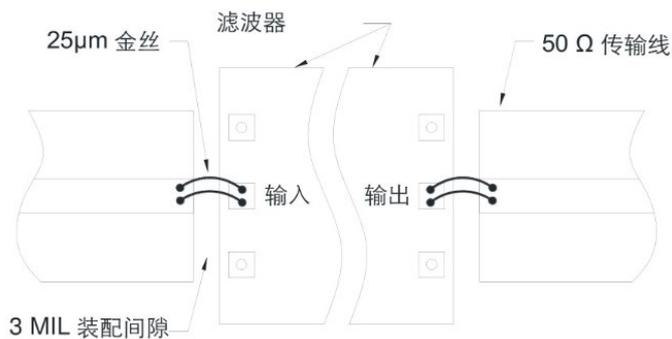
环境参数

2-1	工作温度	-45℃~+85℃
2-2	存储温度	-55℃~+125℃
2-3	最高输入功率	35dBm

外形尺寸

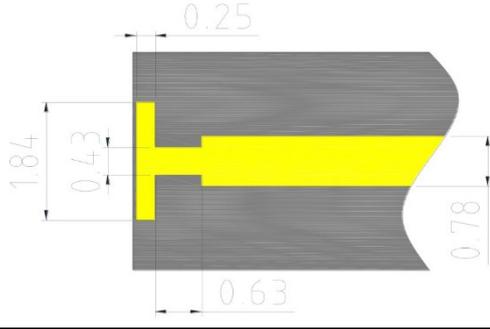
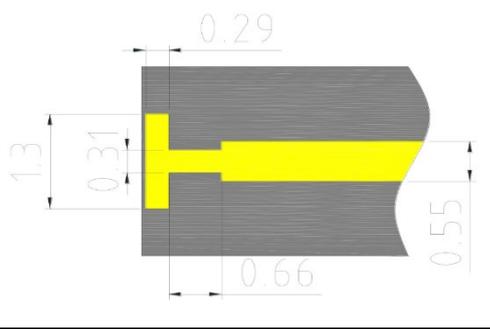
2-1	外形尺寸	见下图（A、B 外形公差： $\pm 0.1\text{mm}$ ）
		
2-2	标识尺寸	A: 4.3mm B: 2.4mm （图中尺寸单位为 mm，A、B 外形公差： $\pm 0.1\text{mm}$ ）
2-3	基板材料	陶瓷
2-4	表面处理	镀金

建议装配图



注意事项

- 1、芯片建议分腔使用，两侧距离侧壁0.2mm左右，表面距离上盖板0.75mm左右，芯片端口可互换；
- 2、芯片应安装在可伐或钼铜等与陶瓷热膨胀系数（6.7ppm/ $^{\circ}$ C）相当的载片上，载体厚度 \geq 0.2mm；
- 3、芯片推荐使用低应力导电胶粘接；
- 4、电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用T型结构进行匹配，T型节尺寸如下：

电路板Rogers5880, 5mil厚	电路板Rogers4350, 5mil厚
	
适用频率：DC-38GHz	适用频率：DC-32GHz
注：T型图形顶端基板白边50 μ m；频率10GHz以下无需匹配	

仿真结果：

